

# ICEP-HBS2026 スポンサー募集

**2026.4/14 (Tue) ~ 4/18 (Sat)**

会場：広島国際会議場（広島県）

ICEP-IAAC (Int'l Conf. on Electronics Packaging & iMAPS All Asia Conf.) 2025では、貴社のロゴや広告の掲載、機器等展示、レセプション参加など、様々な特典をご用意してConference Sponsorsを募集しております。

本国際会議では、電子実装分野の根幹をなすGeneral Sessions (Advanced Packaging, Design, Modeling and Reliability, Emerging technologies, High-Speed, Wireless & Components, Interconnections, Materials and Processes, Optoelectronics, Power Electronics, Thermal Management) のほか、注目を集めているGlass Packageや3D Chipletのsessionも予定しております。

例年、10カ国以上から700名近い参加者を集めるこの機会を、ぜひとも貴社の広報や人的ネットワーク拡大にお役立てください。お申し込みをお待ちしております！

蔵文 FP70159



広島神社 鳥居

***Toward Sustainable AI Computing Era***



主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

<https://www.jieep.or.jp/icep>

## ENTITLEMENT

		Diamond Sponsor ¥600,000	Platinum Sponsor ¥400,000	Gold Sponsor ¥250,000	Silver Sponsor ¥100,000
ロゴ掲載	Additional Logo recognition 1 ICEP-IAC2025ホームページ・プログラム・セッション休憩中の一般講演会場スクリーンセイバー	✓	✓	✓	✓
	Additional Logo recognition 2 参加登録画面	✓	✓	—	—
	Additional Logo recognition 3 参加者名札	✓	—	—	—
広告	Advertising Opportunities 1 オフィシャルプログラムと論文集 (A4 1P)	✓	✓	—	—
	Advertising Opportunities 2 セッション休憩中の一般講演会場スクリーンセイバー (PPT1枚)	✓	✓	—	—
	Advertising Opportunities 3 宣伝動画投影 (3分程度) 1. いずれかのKeynote講演の前のKeynote会場スクリーン 2. 機器展示エリアもしくは受付付近	✓	—	—	—
Booth included in sponsorship 展示ブース 設置期間：4/15(水)-17(金)		✓	✓	✓	—
Contact Information of Registered Attendees that Opt-In 参加者リスト (掲載許可のある方のみ)		✓	✓	✓	✓
Complimentary Registrations (persons) 参加招待 (名)		3	2	1	—
Limitation of sponsor application (on a FCFS basis) 申し込み上限数		5	5	35	—

### ◎各特典について：

- ・それぞれの特典をお使いいただくかどうか、ご選択いただけます。
- ・お申し込みの後に事務局から確認のご連絡をいたしますので、お使いになる特典をお選びください。
- ・DiamondとPlatinumにはオプションで参加者優待をお付けできます。

### ◎展示ブースについて：

- ・パネル1枚(幅：180cm 高さ210cm程度)と長机1台(幅：180cm 奥行：60cm程度)のスペース、椅子2台を提供いたします。
- ・4/15-17の午後のBreak Timeでは、**展示ブースエリアでコーヒー等飲み物をご提供いたします。**
- ・4/16の夕刻には展示ブースエリアにて、**会議参加者を交えたSponsors Exhibition Eventを開催いたします。**
- ・展示場所は委員会で決定させていただきます。

### ◎申込数の上限について：

- ・スポンサーの各クラスについて、表のように申し込み数上限を設けております。先着順となりますので、ご興味をお持ちの場合はお早めにお申し込みください。

## SPONSOR REGISTRATION

ICEP-HBS2026 HPより、**2026年1月30日まで**にお申し込みください。

スポンサーお申し込みページ URL：<https://www.jiep.or.jp/icep/sponsor>

## INQUIRY

ICEP-HBS 2026組織委員会事務局（エレクトロニクス実装学会）

E-mail: [icep2026@jiep.or.jp](mailto:icep2026@jiep.or.jp) URL: <https://www.jiep.or.jp/icep/>